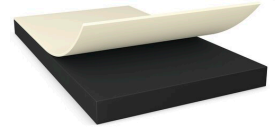




# 58477

## 제품 정보



reactive HAF 반응성 열압착 필름 테이프

### 제품 설명

tesa HAF® 58477 제품은 페놀 수지 및 니트릴 고무 기반의 경화성 열압착 필름입니다. 이 블랙 양면 테이프는 무기재료, 튼튼한 종이 라이너로 보호된다.

조립 과정에서 가해지는 열과 압력에 의해 활성화된다.

### 특성

- Reliable and ageing-resistant bonds
- Extremely high performance, even on small bonding areas and thin design gaps
- Very low oozing ratio
- Suitable for long-term applications that are exposed to heavy stress
- At room temperature tesa HAF® 58477 is not tacky.
- tesa HAF® 58477 is free of halogen and compliant with current ROHS standards.

### Applications

tesa HAF® 58477 금속 표면 또는 내열 플라스틱(예: SUS 또는 AL to PI, PMMA 또는 ABS)에 금속 구성 요소를 접합하는데 특히 권장됩니다.

- Constructive bonding inside electronic devices
- FPC bonding
- Button fixation
- Camera lens and bezel mounting
- Bonding of decorative metal components

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### 제품 구조

- |          |                 |       |       |
|----------|-----------------|-------|-------|
| • 기재 소재  | 없음              | • 총두께 | 20 µm |
| • 접착제 종류 | 니트릴고무 /<br>페놀수지 | • 컬러  | 검정    |
| • 이형지 종류 | 글라신지            |       |       |

### 속성 / 성능 값

- 접착력 7 N/mm<sup>2</sup>

관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58477>



# 58477

## 제품 정보

### 추가정보

Technical recommendations:

tesa HAF<sup>®</sup> is not self adhesive. It is activated by heat and pressure over a certain interval. The following values are recommendations for bond line parameters to start with.

#### 1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the first substrate. This step does not affect the shelf life time of the adhesive tape. Pre-laminated components can be stored over the same period of time as the adhesive tape.

setting:

- Temperature<sup>1</sup> 95-120 °C
- Pressure<sup>2</sup> 2-6 bar
- Time 3-10 s

#### 2. Bonding:

Remove the liner from tape after pre-lamination step. Place the pre-laminated part onto the second substrate. Apply sufficient temperature while applying pressure for the bonding time to reach sufficient bonding strength.

setting:

- Temperature<sup>1</sup> 120-250 °C
- Pressure<sup>2</sup> 5-30 bar
- Time 5-180 s

Temperature, pressure and time will depend upon the type and thickness of the substrates. Generally, thicker substrates or lower bonding temperatures will require longer bonding times. To achieve optimum performance a cooling step (while applying pressure) directly after the bonding step is recommended.

<sup>1</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' temperature refer to the data that is measured in the bond line.

<sup>2</sup> 'Pre-lamination' and 'Bonding' pressure refer to the force that is transformed from jig surface directly to the bonding area.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. (Material: etched aluminum test specimen / bonding conditions: temperature = 180 °C; pressure = 10 bar; time = 7 sec).

To reach maximum bonding strength surfaces should be clean and dry. Storage conditions according to tesa HAF<sup>®</sup> shelf life concept.



# 58477

## 제품 정보

### 공지사항

테사에서 판매하는 제품들은 엄격한 품질관리를 통해 생산되고 있으며, 테사에서 제공하는 전문적인 정보들은 오랜기간의 경험을 기반으로 하고 있습니다. 관련 정보는 평균값에 근거하며, 특별한 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. tesa SE는 관련 정보의 명시적 또는 암묵적인 보증을 하는 것은 아니며, 이는 특별한 용도에 적합성 또는 상업성과 관련한 어떠한 암묵적인 보증도 포함하지 않습니다. 사용자는 제품을 사용하기 전에 적용부위에 적합한지를 검토하시기 바라며, 기타 문의사항이 있으시면 저희 직원에게 문의 바랍니다



관련제품 최신자료는 다음의 경로를 클릭하세요 <http://l.tesa.com/?ip=58477>